



A BRAND NEW WORLD OF MOBILE

Powered by Exynos mobile processor Unmatched performance, incredible 3D graphics. Take your mobile to the next level with more advanced CPU and GPU performance combined with Samsung's industry-leading low energy-consumption technology.



Ultimate Performance with
Green Technology

Samsung Exynos
Processor

Samsung System LSI Business

System LSI Business is a global leader in designing and manufacturing a variety of Large Scale Integrated circuit (LSI) products and System-on-Chip(SoC) solutions, as well as offering Foundry services. Samsung's leading LSI products include Application Processors (AP), CMOS Image sensors (CIS), Display Driver IC (DDI), Smart Card IC, and Near Field Communication (NFC) IC.

지원자격

- 전공 : 반도체 및 관련 학과
(전기전자/재료공학/화학공학/컴퓨터/물리학 등)
- 학위 및 경력
 - 박사 학위 소지자 및 취득예정자
 - 석사 학위자의 경우 경력 2년 이상 보유자
 - 기졸업자로서 반도체 관련업체에 재직중인 자
 - 해외여행에 결격사유가 없으며 한국 근무가 가능한 자

모집부문

업무	해당 전공
Circuit Design	전기전자, 광학
소자 / 공정개발	전기전자, 재료, 화학/화공, 물리, 전력
IP Design	전기전자, 컴퓨터
S / W	컴퓨터, 전기전자
CAE	전기전자, 컴퓨터
PE / Test	전기전자, 컴퓨터, 통계
Yield Enhancement	전기전자, 재료, 금속, 물리, 통계

채용 절차

- 수시 지원: 이메일로 최신이력서 송부(E-mail: minjung.ki@samsung.com)
- 서류 전형 및 전화면접
- 현지 면접
- 신체 검사

기타

- 문의사항이 있으시면 언제든지 아래 연락처로 연락 주시기 바랍니다.
- 문의처 : 기민정 대리 (+82-31-209-0950, minjung.ki@samsung.com)

● System LSI 최근 주요 성과

- 차세대 픽셀기술(ISO Cell) 개발 (Sep.,2013)
- bigLITTLE 기술 적용 옥타코어 모바일 프로세서 개발 (Jan.,2013)
- 모바일AP 브랜드 Exynos 런칭 (Dec.,2011)
- Market Share 1위 (2012)

제품	DDI	Smart Card	Mobile AP	CIS
기간	for 11Y	for 7Y	for 3Y	for 4Y
M/S	17.3%	60.2%	67.4%	25.8%

※Mobile AP는 Mobile Phone Stand-Alone type 기준

※CIS는 카메라폰 向 CIS 이미지센서 시장 기준



● System LSI 업무 분야

업무	기술분야	해당전공
Circuit Design	- Digital: Mobile AP, MP3 SOC, D-TV SOC, CPU/GPU - Analog: DDI, CIS, Smart Card IC, Power Management IC - Cellular Modem/Wireless Connectivity	전기전자 광학
소자/ 공정개발	- Advanced Logic Process Development & Integration · Oxidation, Photolithography (OPC), Etch, High-K/MG, Thin Film, SiO2/SiON Gate Dielectric, Silicide, Cu/Ultra Low-K, Strain Engineering - Device & Reliability Engineering · Device Physics, Strain Modeling, SPICE Modeling - Power Device Process Development, Integration, Device	전기전자 재료, 화학/화공 물리,전력
IP Design	- Multimedia IP (Image/Video/Graphics/Bus/Memory Controller) - Firmware, VHDL, Verilog Design, FPGA Implementation	전기전자 컴퓨터
S/W	- Firmware, Middleware, Device Driver, OS - SQA, Embedded System S/W, Solution Development	컴퓨터 전기전자
CAE	- Device Modeling, Process modeling, CAD, TCAD - DfX (Design for Manufacturing, Design for Test)	전기전자 컴퓨터
PE/Test	- Pattern inspection, Si Validation, DFT Development	전기전자 컴퓨터,통계
Yield Enhancement	- Physical Failure Analysis (STEM,SEM,FIB) - Defect Analysis & Monitoring System Set up	전기전자,재료, 금속,물리,통계